

【証券コード:6728】

# 決算説明会 (2013年6月期)

2013年8月14日

株式会社 アルバック

## ◆将来見通しに関する記述についての注意事項

このプレゼンテーション資料で述べられている将来の当社に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに作成されたものです。当社グループのお客様であるフラットパネルディスプレイ(FPD)・半導体・太陽電池・電子部品などの業界は技術革新のスピードが大変速く、競争の激しい業界です。

また、世界経済、為替レートの変動、FPD・半導体・電子部品・原材料などの市況、設備投資の動向など、当社グループの業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。したがって、実際の売上高および利益は、このプレゼンテーション資料に記載されている予想数値とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

## ◆本資料における表示方法について

(特段の記載がない限り、数値はすべて連結ベースです)

数値： 単位未満四捨五入

比率： 百万円単位で計算後、単位未満四捨五入

会計期間の表現：

2Q(累計)：第2四半期連結累計期間

2Q : 第2四半期連結会計期間

# アジェンダ

ごあいさつ  
～事業構造改革の実績

代表取締役執行役員社長  
小日向久治

2013年6月期連結業績概要

執行役員経理部長  
佐藤孔史

2014年6月期連結業績予想

代表取締役執行役員社長  
小日向久治

質疑応答

# 事業構造改革の実績(1)

<h2>1.開発戦略</h2>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・PM中心の開発体制の確立</li> <li>・商品開発進捗のマイルストーン管理方法決定</li> </ul>
<h2>2.営業戦略</h2>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・PM体制・「アルバック販売」体制見直し実施</li> <li>・国別戦略(ロードマップ)作成中</li> <li>・営業本部に2名の取締役を配置し、トップ営業を強化</li> </ul>
<h2>3.コスト競争力強化</h2>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・売上総利益率改善 12/6期 14.4%→13/6期 22.6%</li> <li>・追加コスト削減 25億円(単体)</li> <li>・サプライヤの選択と集中(12/6期 421社→13/6期 135社)</li> <li>・グローバル生産体制の確立及びグローバル生産企画室設立</li> </ul>
<h2>4.経費削減</h2>	<p>固定費削減 12/6期 377億円→ 13/6期 260億円(単体)  (うち 経費 12/6期 118億円→ 13/6期 71億円)</p>
<h2>5.利益計画</h2>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業部毎の収益計画責任明確化定着</li> <li>・事業部毎に計画対比実績管理強化・徹底</li> <li>・損益の見える化で不採算製品の見直し実施</li> </ul>

# 事業構造改革の実績(2)

<b>6.人事制度改革</b>	人事制度改革実施（給与体系見直し・賞与の変動費化）
<b>7.スリム化</b>	棚卸資産圧縮 12/6期 572億円 → 13/6期 439億円 資金繰り管理強化の観点から、債権回収管理強化の仕組み導入 遊休不動産売却(2件)。対象物件の売却活動進捗管理強化
<b>8.業務改革</b>	会議の見直し（40%削減） 事務の手続き簡素化、業務プロセス見直し
<b>9.リスクマネジメント</b>	与信管理強化 フロントローディング徹底＝受注前審査制度導入（与信、技術リスク等） 技術リスクのP/L、B/S、C/Fへの影響把握体制確立
<b>10.グループ経営管理</b>	関連会社管理強化 グローバル生産企画室設立

# アジェンダ

ごあいさつ  
～事業構造改革の実績

代表取締役執行役員社長  
小日向久治

**2013年6月期連結業績概要**

**執行役員経理部長  
佐藤孔史**

2014年6月期連結業績予想

代表取締役執行役員社長  
小日向久治

質疑応答

## 2013/6期業績

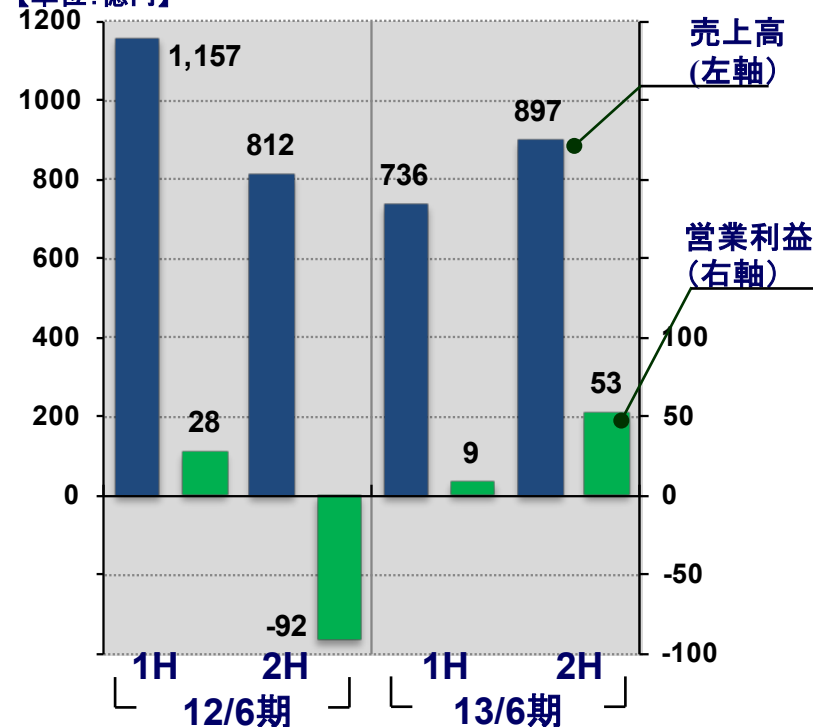
受注、売上は概ね前回予想値並の着地。営業利益は、売上原価や固定費の削減を更に進め61億円(前回予想比+7億円)の黒字。経常利益は、このことに加え、営業外収支の改善もあり63億円の黒字(前回予想比+25億円)となった。材料部門で一部不採算事業の取引見直しを行うことにもなう、特別損失の計上により、当期利益は38億円の赤字(前回予想比14億円の赤字縮小)。

【単位:億円】

	12/6期	13/6期		
		前回予想 (6/5発表)	実績	差異
受注高	1,522	1,670	1,668 (+10%)	-2
受注残高	650		725	
売上高	1,968	1,650	1,634 (-17%)	-16
売上総利益	284		370	
率	14.4%		22.6%	
販管費	347		308	
営業利益	-64	54	61 (-)	7
率	-3.2%	3.3%	3.7%	
経常利益	-65	38	63 (-)	25
率	-3.3%	2.3%	3.8%	
特別利益	2		3	
特別損失	274		71	
税金費用	156		25	
少数株主損益	7		7	
当期純利益	-500	-52	-38	14

## 売上高と営業利益の推移(半期毎)

【単位:億円】



【( )内は前年同期比、増減率、百万円単位で計算後、単位未満四捨五入】

## 品目別受注高・売上高の実績

受注では、FPD製造装置や半導体製造装置を中心に設備投資の延期・縮小が続いていたが、期末に向け、一部設備投資の動きが見られ、前年同期比10%増加。

売上では、大型液晶ディスプレイ関連やメモリ関連の設備投資の回復の遅れにともない、FPD製造装置や半導体及び電子部品製造装置を中心に全体で前年同期比17%の減少。

### 品目別受注高

【単位：億円】

2012/6期		2013/6期	
セグメント及び品目		受注高 (実績)	前年同期比 (増減率)
真空機器事業	1,149	1,303	13%
FPD及びPV製造装置※	467	673	44%
半導体及び電子部品製造装置	258	185	-28%
コンポーネント	207	233	12%
一般産業用装置	217	211	-3%
真空応用事業	373	365	-2%
材料	151	139	-8%
その他	222	226	2%
合計	1,522	1,668	10%

### 品目別売上高

2012/6期		2013/6期	
セグメント及び品目		売上高 (実績)	前年同期比 (増減率)
真空機器事業	1,599	1,273	-20%
FPD及びPV製造装置※	862	577	-33%
半導体及び電子部品製造装置	292	224	-24%
コンポーネント	222	234	5%
一般産業用装置	223	239	7%
真空応用事業	369	361	-2%
材料	159	139	-12%
その他	210	222	5%
合計	1,968	1,634	-17%

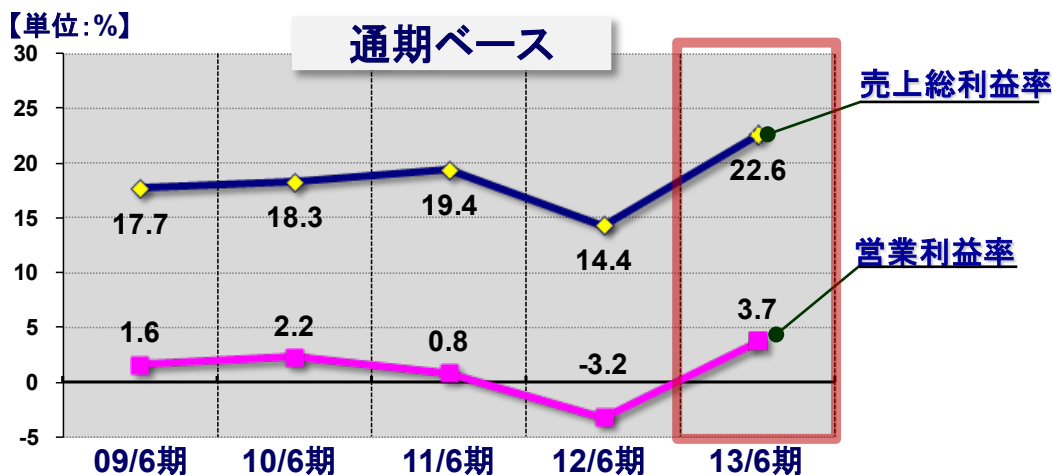
※12/6期と13/6期を比較するため、12/6期のFPD製造装置とPV製造装置を合算しています。

【記載された金額は四捨五入しておりますので各項目の合計値が一致しない場合があります。】

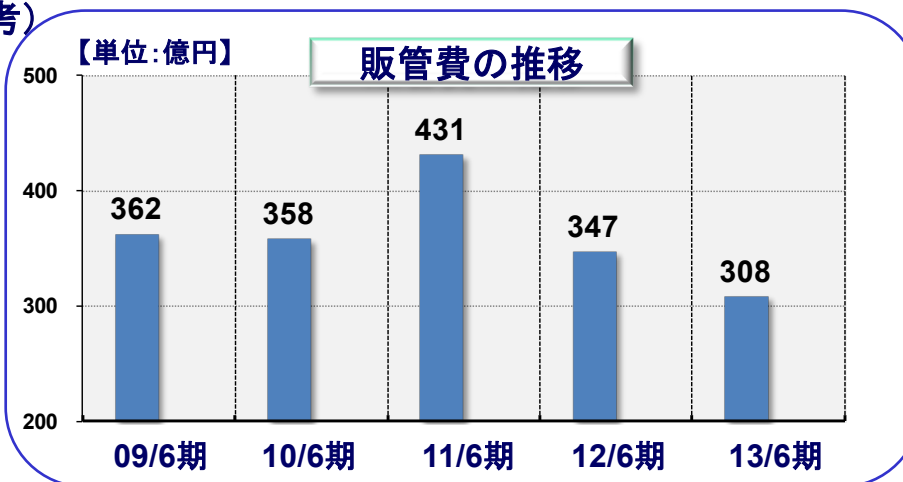


# 利益率の推移

追加コストの削減や固定費の削減効果を主因に、売上総利益率、営業利益率とも前期比改善。



(参考)



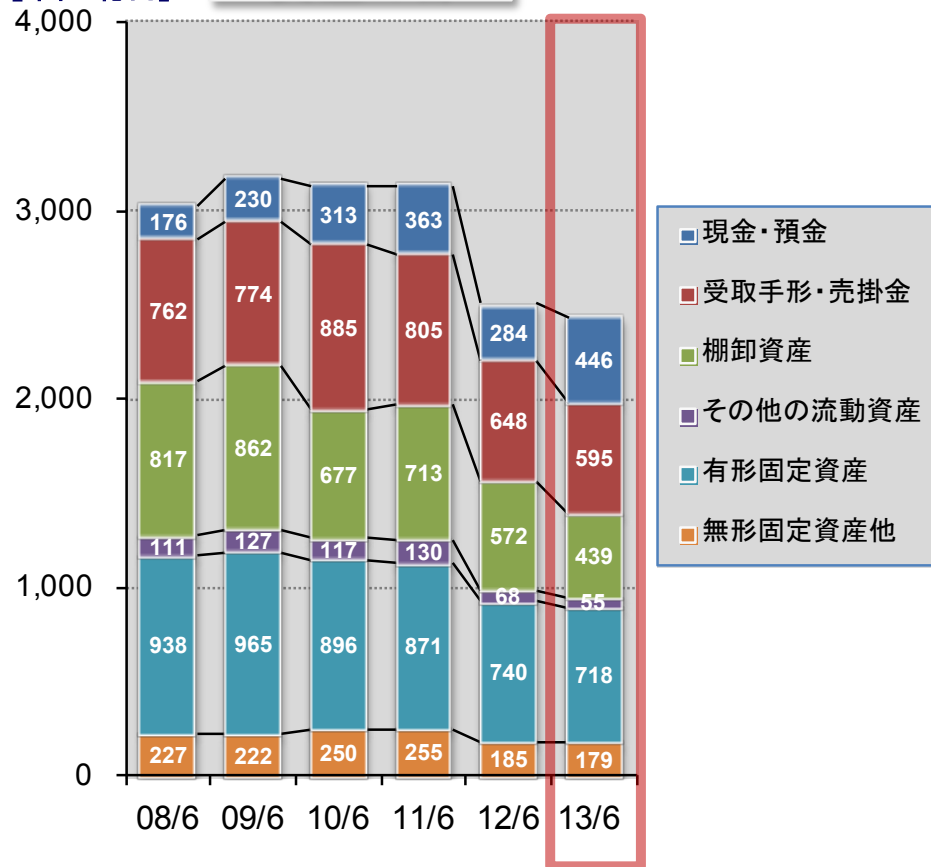
【小数点以下第2位は四捨五入】

# 連結貸借対照表

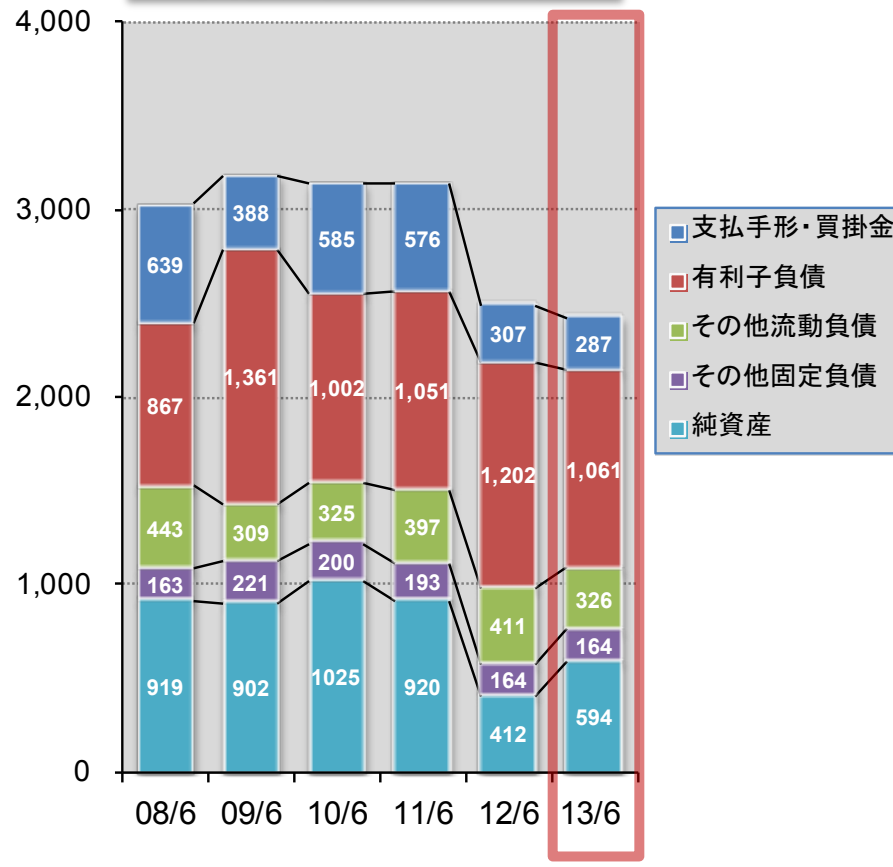
種類株発行(150億円)を主因に、自己資本が増加(自己資本比率は22.7%)

## 資産の部

【単位:億円】



## 負債・純資産の部

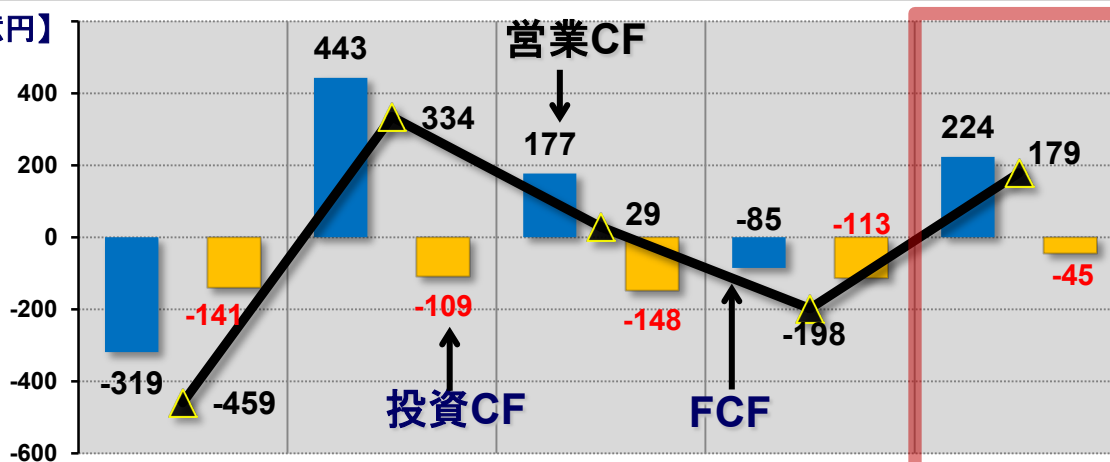


【記載された金額は四捨五入しておりますので各項目の合計値が一致しない場合があります。】

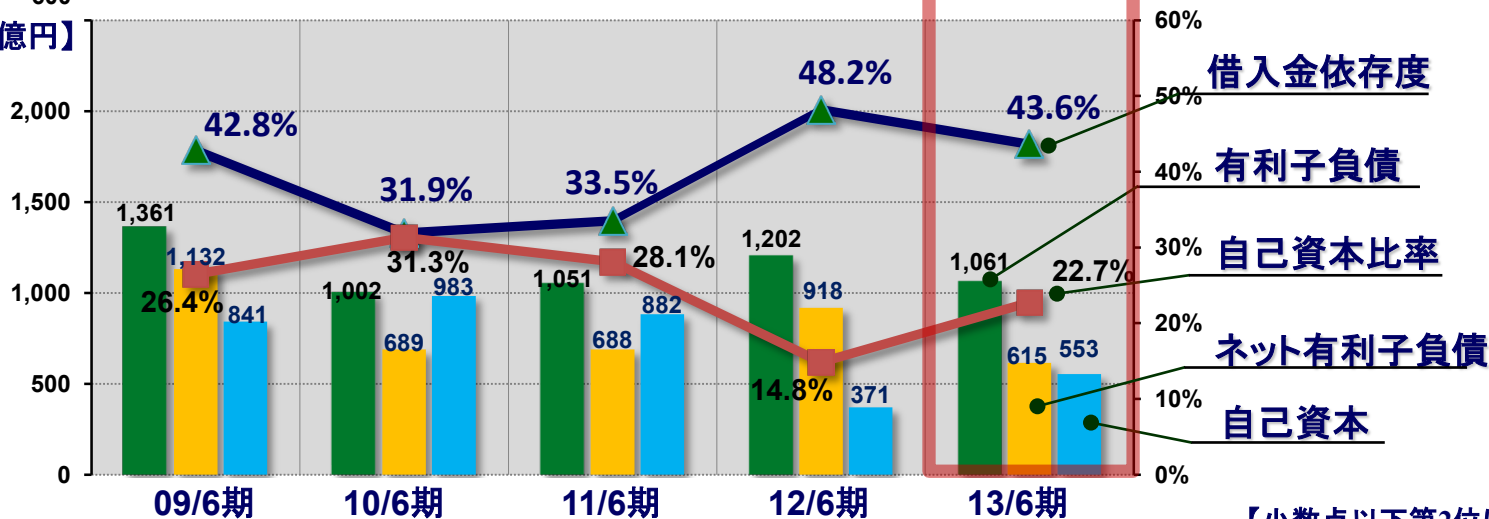
# キャッシュ・フローと有利子負債の実績

営業キャッシュ・フローの改善と投資キャッシュ・フローの赤字縮小によりフリーキャッシュ・フローが改善。

【単位：億円】



【単位：億円】



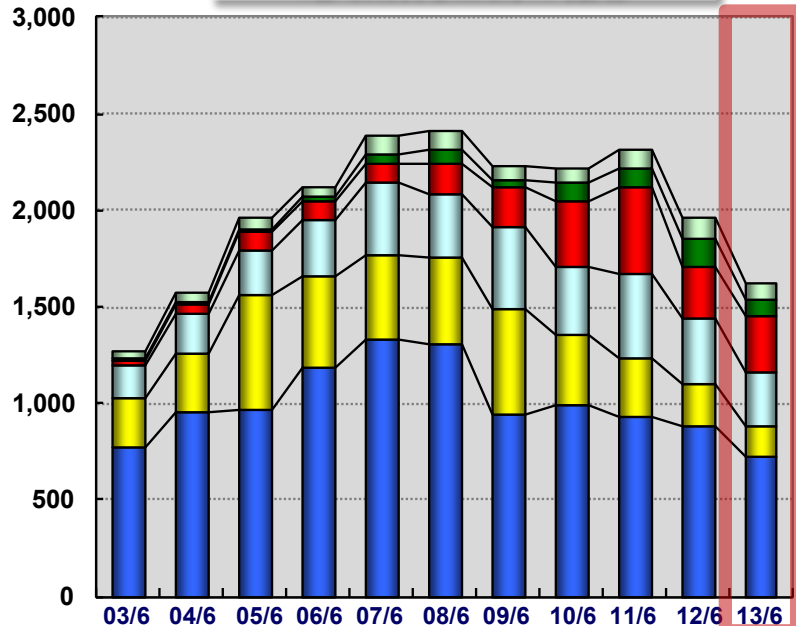
【小数点以下第2位は四捨五入】

# 地域別売上高の推移

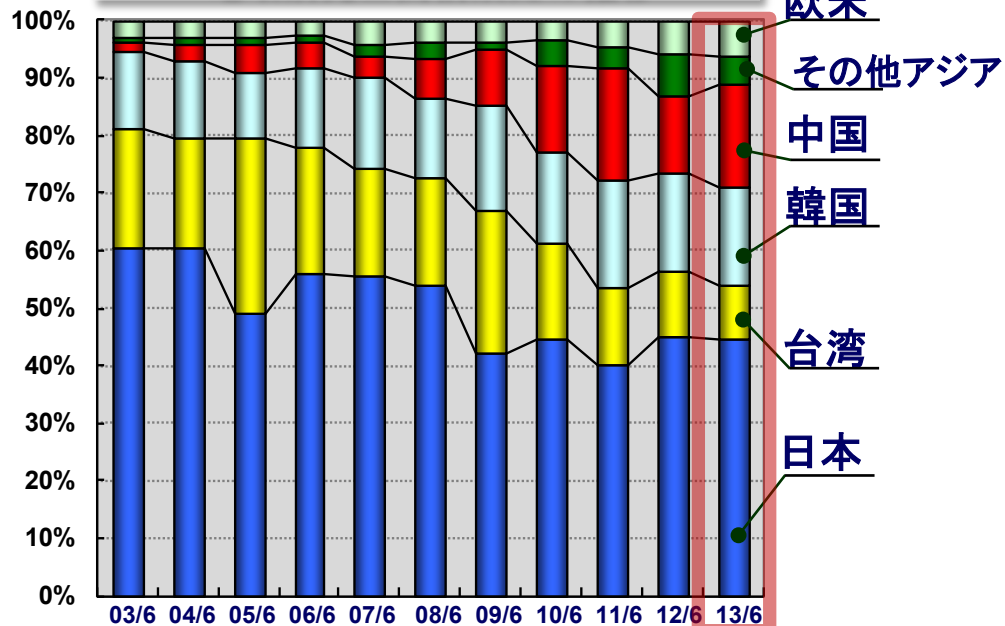
日本、台湾、韓国向け売上高の減少が続く一方、中国向けが増加。

【単位:億円】

地域別売上高の推移



地域別売上高構成比の推移



	03/6		04/6		05/6		06/6		07/6		08/6		09/6		10/6		11/6		12/6		13/6		
	売上高	比率	売上高	比率	売上高	比率	売上高	比率	売上高	比率	売上高	比率	売上高	比率	売上高	比率	売上高	比率	売上高	比率	売上高	比率	前期比
日本	773	61%	953	60%	968	49%	1,189	56%	1,334	56%	1,307	54%	949	42%	995	45%	933	40%	886	45%	732	45%	-17%
台湾	261	20%	304	19%	597	30%	473	22%	442	18%	451	19%	551	25%	369	17%	310	13%	223	11%	153	9%	-31%
韓国	172	13%	211	13%	231	12%	292	14%	379	16%	326	14%	413	18%	354	16%	433	19%	341	17%	281	17%	-18%
中国	22	2%	47	3%	94	5%	96	5%	90	4%	169	7%	212	9%	333	15%	454	20%	261	13%	288	18%	-10%
その他アジア	9	1%	16	1%	21	1%	26	1%	51	2%	70	3%	33	1%	98	4%	89	4%	147	7%	84	5%	-43%
欧米	38	3%	47	3%	57	3%	48	2%	95	4%	89	4%	80	4%	70	3%	102	4%	111	6%	96	6%	-13%
合計	1,275	100%	1,579	100%	1,968	100%	2,125	100%	2,392	100%	2,412	100%	2,238	100%	2,218	100%	2,320	100%	1,968	100%	1,634	100%	-17%

【百万円単位で計算後、単位未満四捨五入】

# アジェンダ

ごあいさつ  
～事業構造改革の実績

代表取締役執行役員社長  
小日向久治

2013年6月期連結業績概要

執行役員経理部長  
佐藤孔史

**2014年6月期連結業績予想**

**代表取締役執行役員社長  
小日向久治**

**質疑応答**

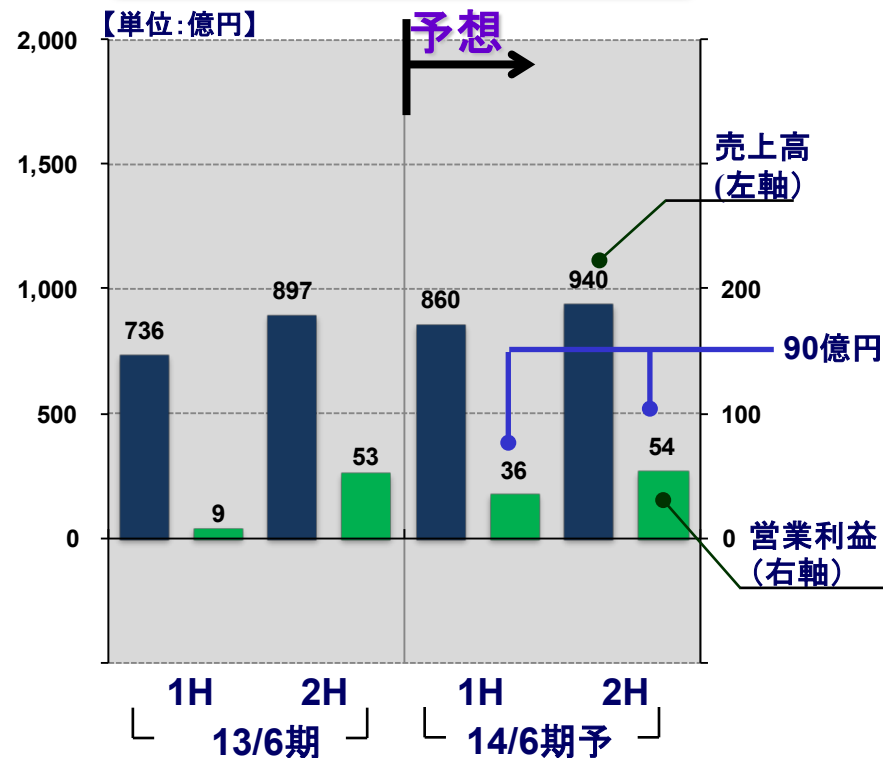
## 2014/6期業績予想

受注は、前年同期比で8%増。売上は、前年同期比で10%増を予想。  
 営業利益は、収益性の高い半導体及び電子部品製造装置の売上増を主因に90億円を  
 予想。当期純利益は、黒字転換を予想。

【単位：億円】

	13/6期 実績	14/6期予	
		2Q(累計)	通期
受注高	1,668	840	1,800
受注残高	725	705	725
売上高	1,634	860	1,800
営業利益	61	36	90
率	3.7%	4.2%	5.0%
経常利益	63	25	70
率	3.8%	2.9%	3.9%
当期純利益	-38	10	40

売上高と営業利益の推移(半期毎)

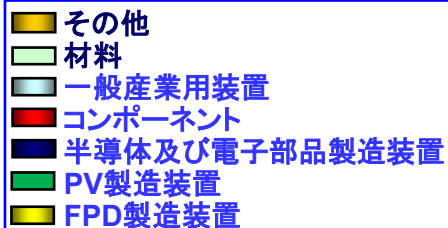
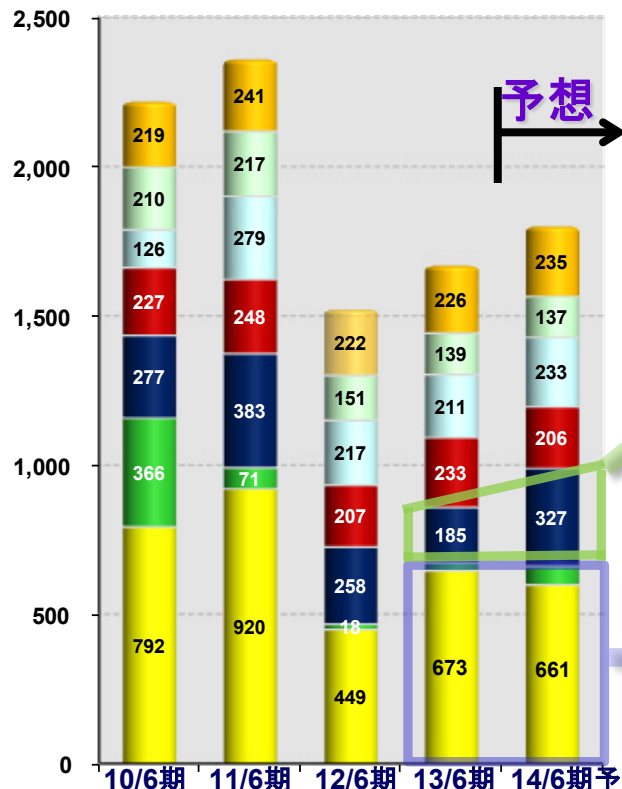


【百万円単位で計算後、単位未満四捨五入】

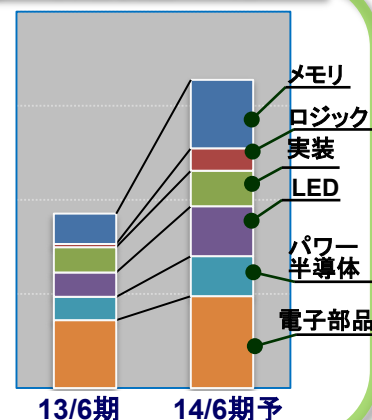
## 品目別受注高実績・通期予想

### 14/6期予想

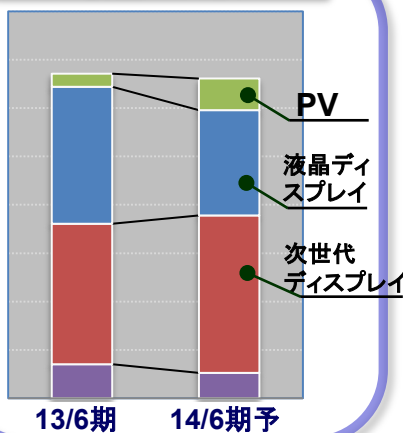
【単位：億円】



#### 半導体及び電子部品製造装置の内訳



#### FPD及びPV製造装置の内訳



- ・メモリ : 中国、日本、米国向けにNANDフラッシュの投資が見込まれる
- ・ロジック・実装 : ファウンドリなど継続的な投資が見込まれる
- ・LED : 日本、中国向けに投資が見込まれる
- ・パワー半導体 : 日本、中国向けに投資が見込まれる
- ・電子部品 : 自動車部品、MEMS、バッテリーなど高機能デバイスの投資が見込まれる

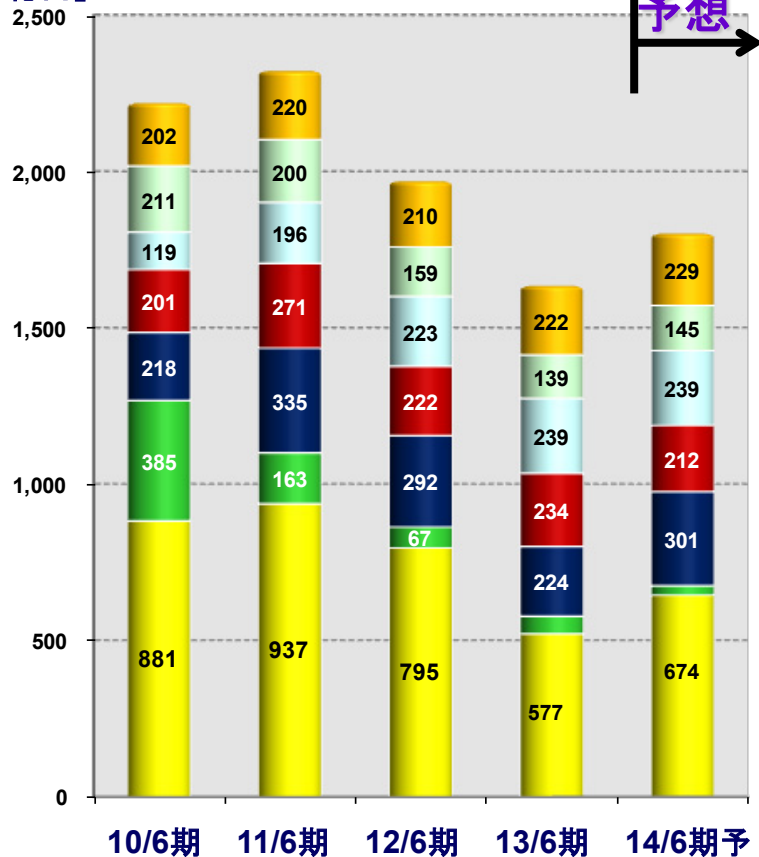
- PV**
- ・PV : 化合物系太陽電池や高効率太陽電池の投資が見込まれる
- FPD**
- ・液晶ディスプレイ : 中小型パネル用が大半を占め、大型用は中国向けのみを見込む。一部IGZO関連も期待
  - ・次世代ディスプレイ : 有機EL関連が中心。中国、台湾など中小型、大型パネル用の投資が見込まれる

【記載された金額は四捨五入しておりますので各項目の合計値が一致しない場合があります。】

# 品目別売上高実績・通期予想

前期に有機ELなどFPD製造装置の受注が積み上がったことと、半導体及び電子部品製造装置の受注増加が見込まれるため、売上高が増加する見込み

【単位：億円】



- その他
- 材料
- 一般産業用装置
- コンポーネント
- 半導体及び電子部品製造装置
- PV製造装置
- FPD製造装置

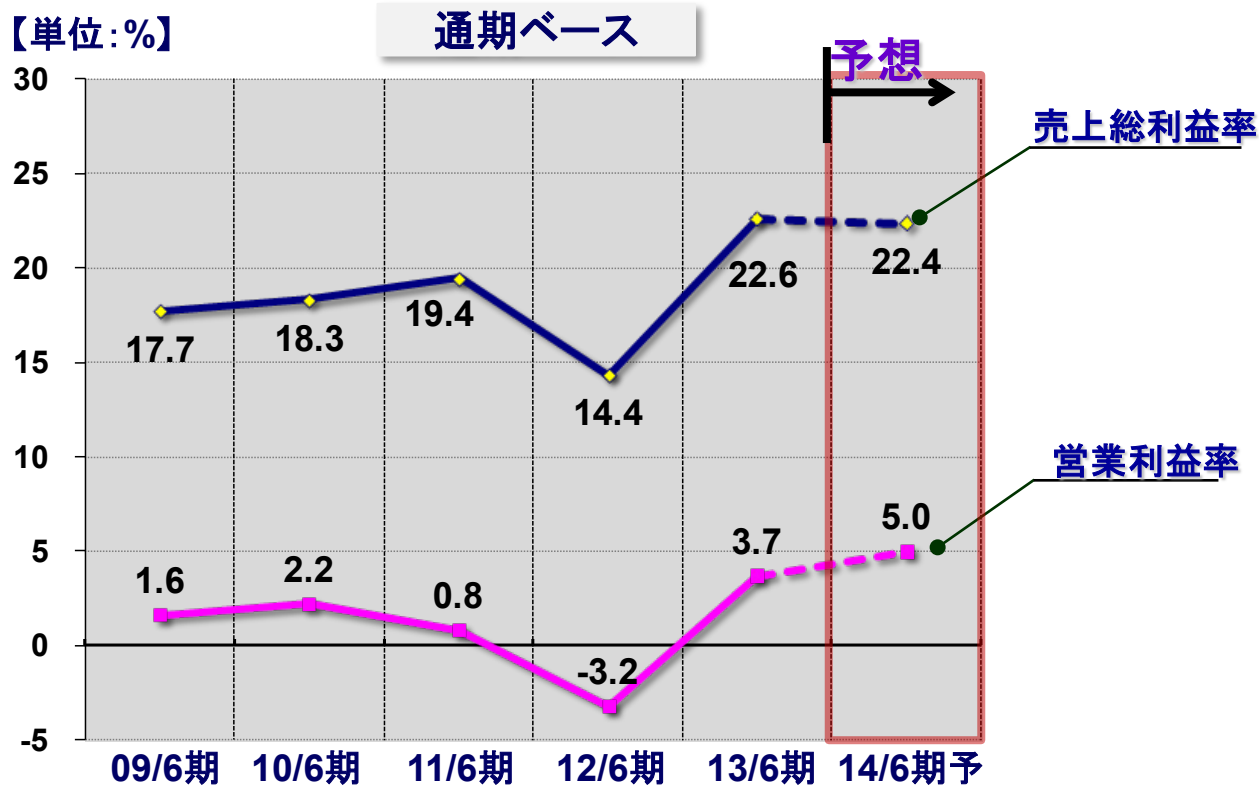
※13/6期から、「FPD製造装置」と「PV製造装置」を統合し、「FPD及びPV製造装置」に変更していますが、グラフの表記のみ、「FPD製造装置」と「PV製造装置」を分けています。

【記載された金額は四捨五入しておりますので各項目の合計値が一致しない場合があります。】



# 利益率の推移・予想

営業利益率は、半導体及び電子部品製造装置の売上増が寄与し、前年同期比で改善を見込む。

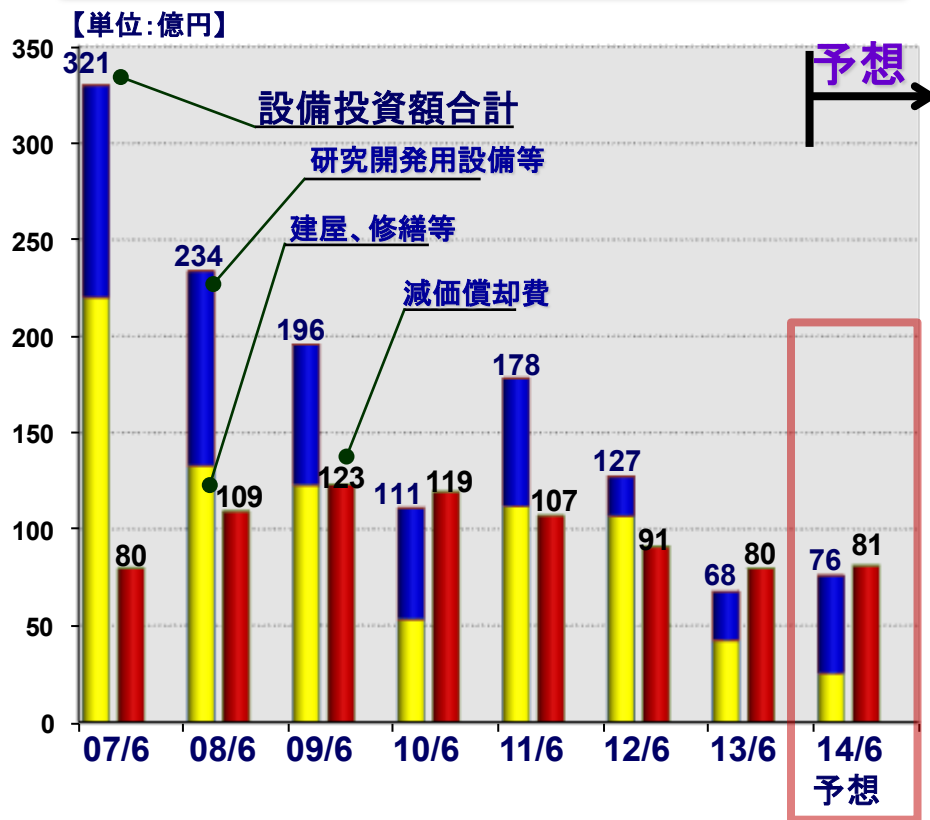


【小数点以下第2位は四捨五入】

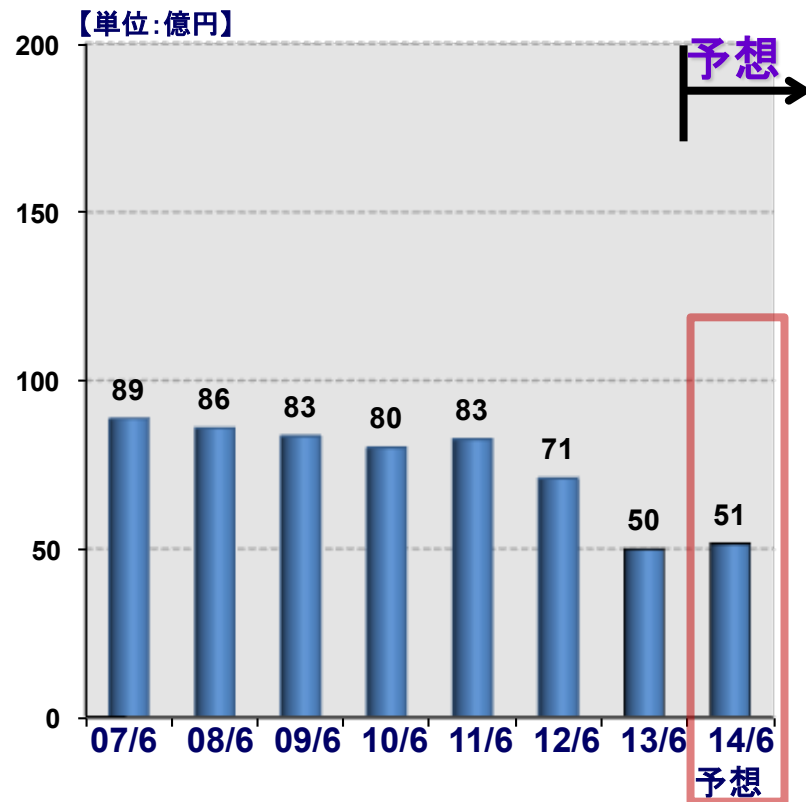
# 設備投資、減価償却費、研究開発費の推移・予想

投資額合計は、減価償却費内を維持。  
 設備投資は、競争力強化のため、研究開発用設備を中心に行う。

設備投資及び減価償却費の推移・予想



研究開発費の推移・予想

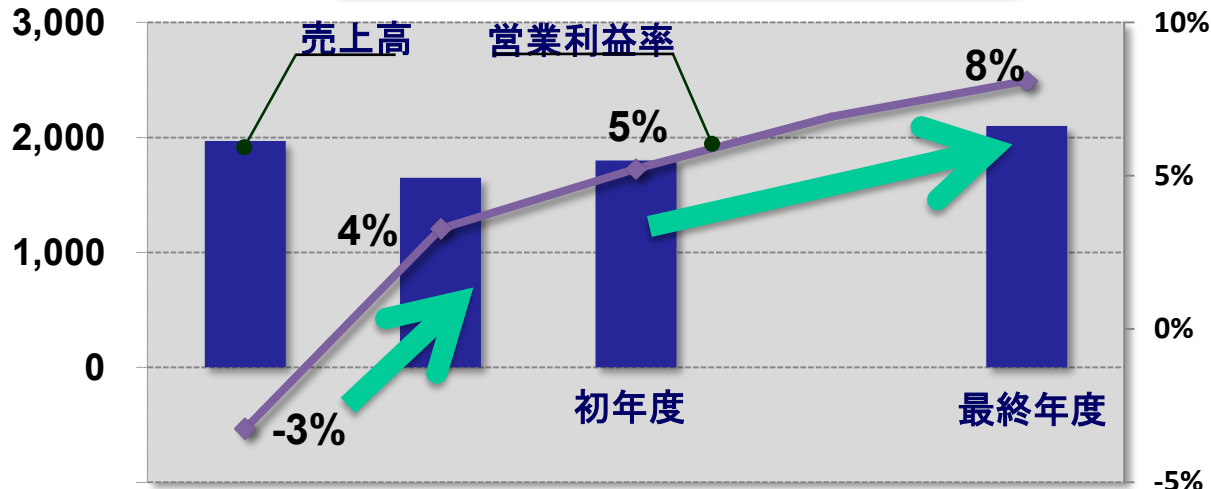


【単位未満は四捨五入】

## 目標数値(連結ベース)

### 売上高と営業利益率

【単位:億円】



### コストダウンの推進

#### ①13/6期

- ・追加コスト削減
- ・集中購買によるコストダウン
- ・採算重視の受注の徹底
- ・固定費の削減

#### ②14/6期以降

- 上記に加え以下を強化
- ・標準化推進
  - ・グローバル生産の最適化
  - ・製品毎の採算管理徹底

	2012/6期	2013/6期	2014/6期 予想	2016/6期 目標
受注高	1,522	1,668	1,800	2,050
売上高	1,968	1,634	1,800	2,050
営業利益 (率)	-64 (-3%)	61 (4%)	90 (5%)	170 (8%)
経常利益	-65	63	70	140
当期利益	-500	-38	40	110

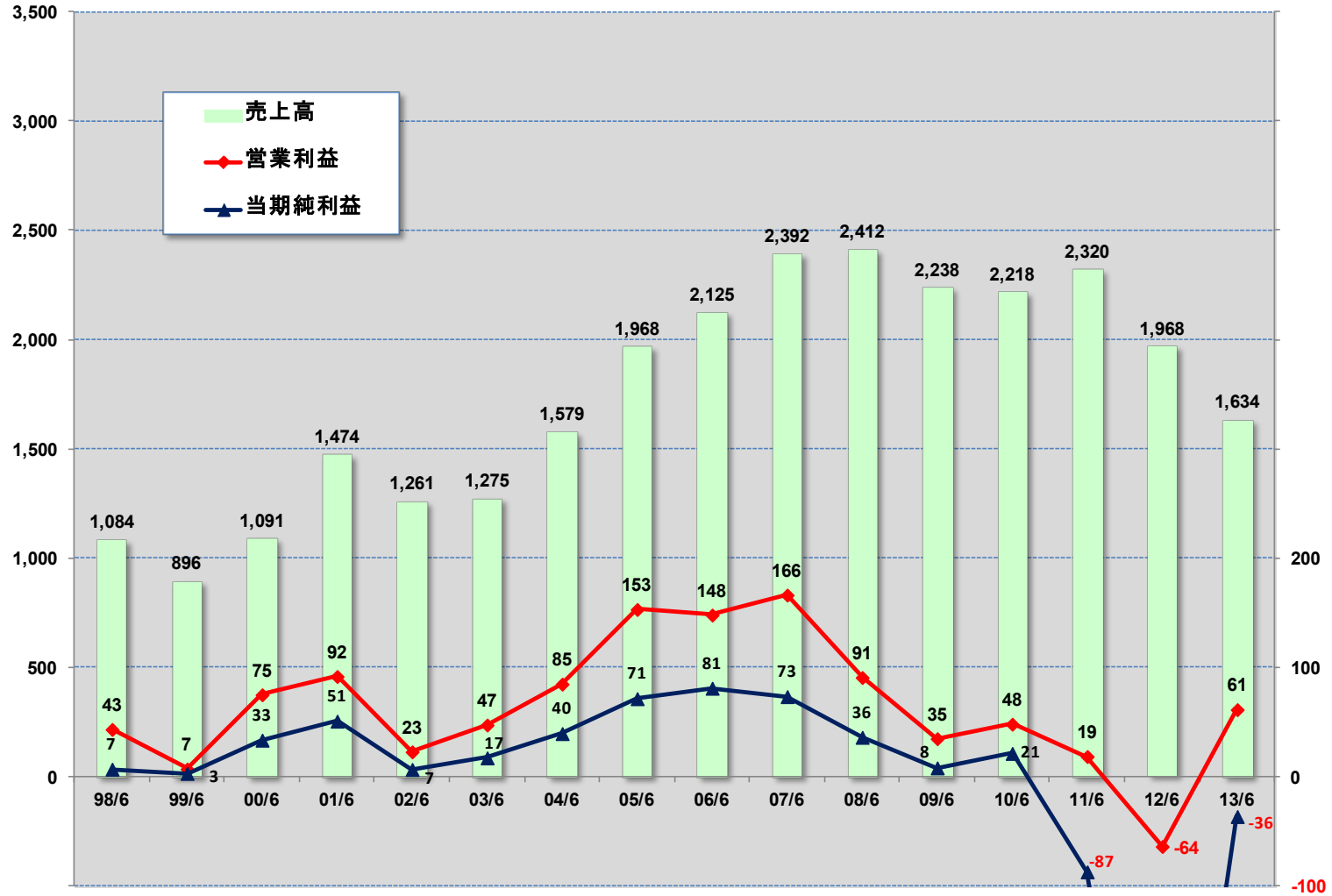
【単位未満は四捨五入】

真空テクノロジーで  
「つくる」をつくる、アルバック  
ULVAC

本日は  
ありがとうございました

# 売上高と利益の推移

【単位:億円】

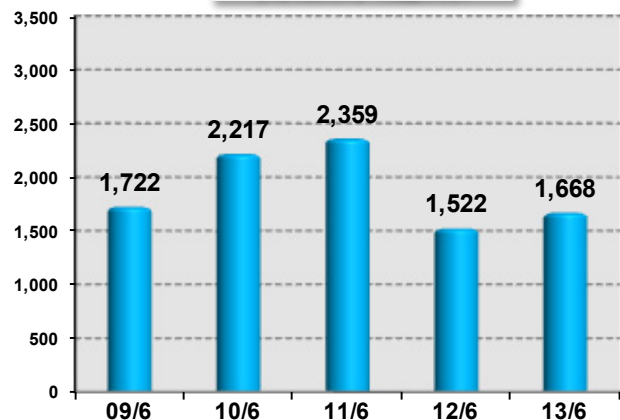


【小数点以下は四捨五入】

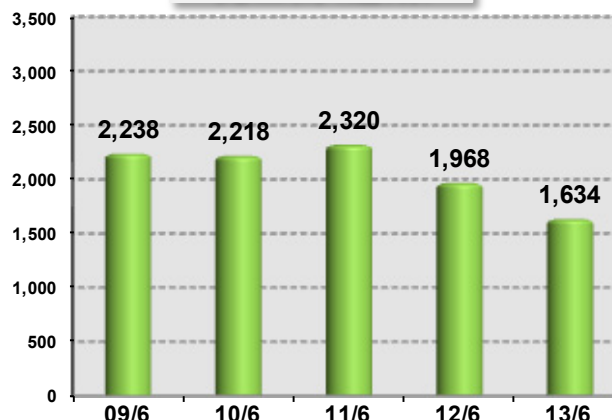
# 受注高・売上高・受注残高の推移

【単位:億円】

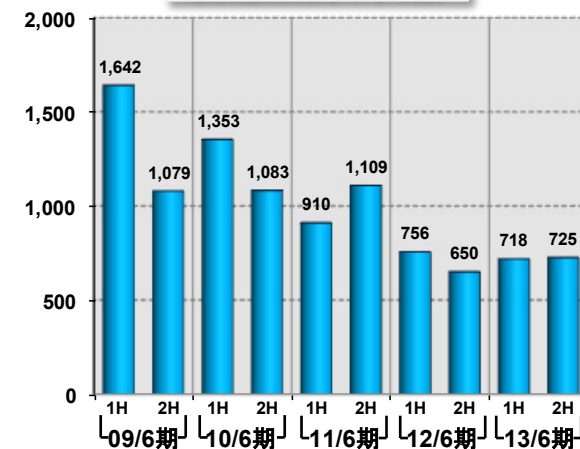
受注高(通期)



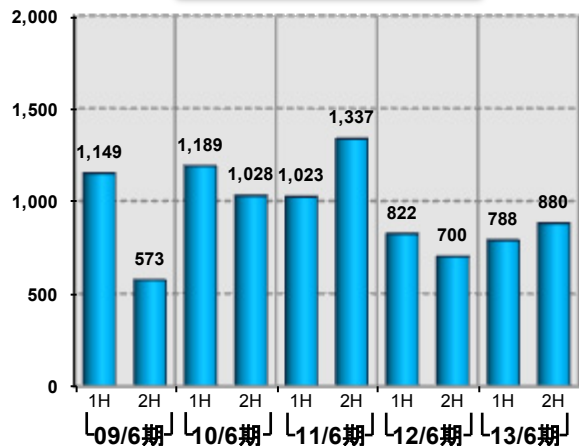
売上高(通期)



受注残高(半期)



受注高(半期)



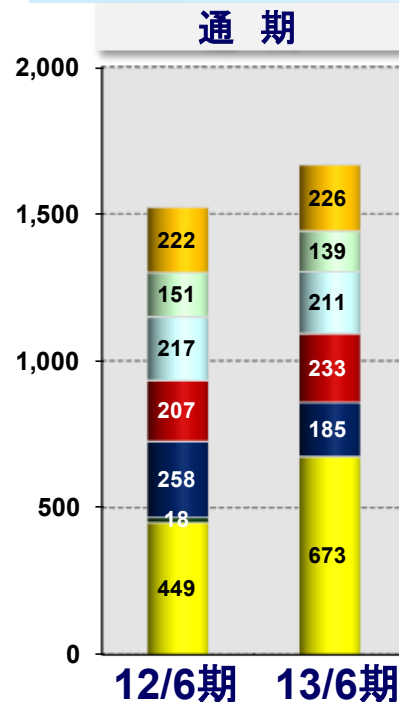
売上高(半期)



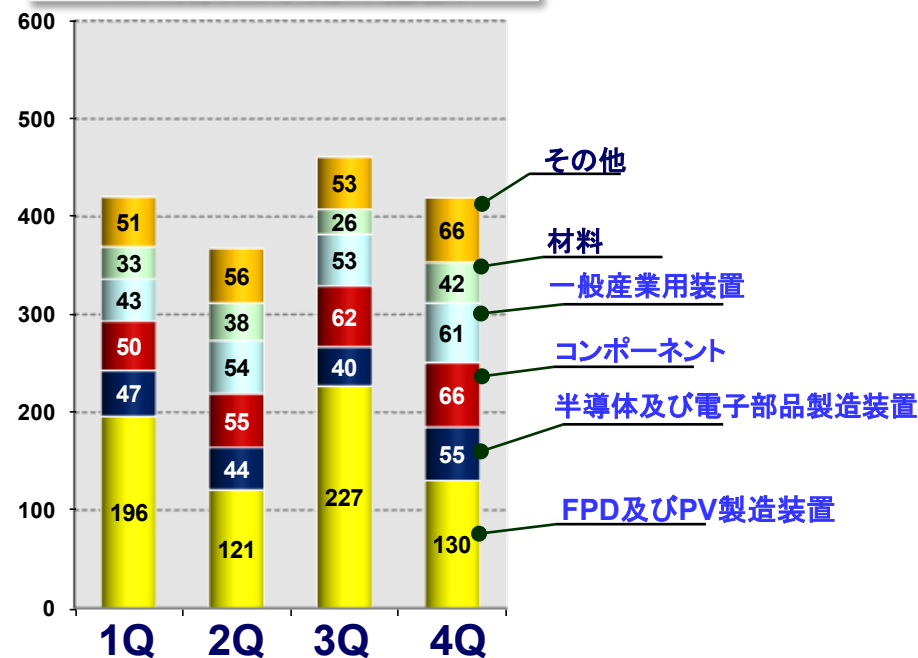
【小数点以下は四捨五入】

# 品目別受注高の実績

【単位：億円】



13/6期(四半期の推移)



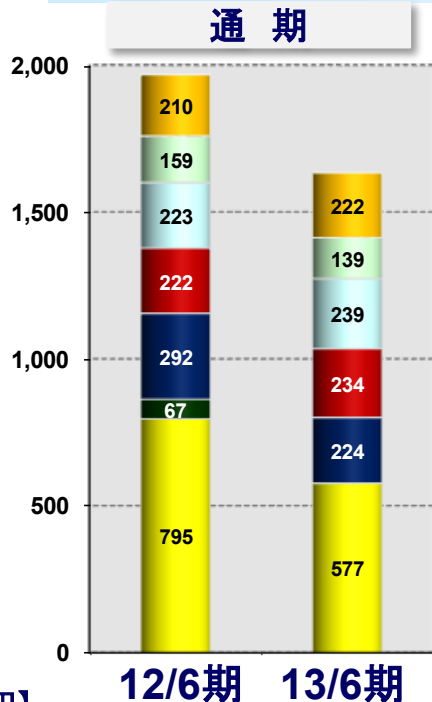
【単位：億円】

12/6期			13/6期			前年同期比 (増減率)	1Q		2Q		3Q		4Q	
セグメント	受注高	構成比	セグメント	受注高	構成比		受注高	構成比	受注高	構成比	受注高	構成比	受注高	構成比
真空機器事業	1,149	75.5%	真空機器事業	1,303	78.1%	13.4%	336	80.0%	273	74.4%	382	82.8%	312	74.3%
FPD製造装置	449	29.5%	FPD及びPV製造装置	673	40.4%	44.2%	196	46.5%	121	32.8%	227	49.2%	130	31.1%
PV製造装置	18	1.2%												
半導体及び電子部品製造装置	258	17.0%	半導体及び電子部品製造装置	185	11.1%	-28.3%	47	11.2%	44	11.9%	40	8.7%	55	13.0%
コンポーネント	207	13.6%	コンポーネント	233	14.0%	12.5%	50	12.0%	55	14.9%	62	13.5%	66	15.7%
一般産業用装置	217	14.2%	一般産業用装置	211	12.7%	-2.5%	43	10.3%	54	14.8%	53	11.5%	61	14.5%
真空応用事業	373	24.5%	真空応用事業	365	21.9%	-2.2%	84	20.0%	94	25.6%	79	17.2%	108	25.7%
材料	151	9.9%	材料	139	8.3%	-8.3%	33	7.8%	38	10.4%	26	5.6%	42	9.9%
その他	222	14.6%	その他	226	13.6%	1.9%	51	12.1%	56	15.3%	53	11.6%	66	15.7%
<b>合計</b>	<b>1,522</b>	<b>100.0%</b>	<b>合計</b>	<b>1,668</b>	<b>100.0%</b>	<b>9.6%</b>	<b>420</b>	<b>100.0%</b>	<b>368</b>	<b>100.0%</b>	<b>461</b>	<b>100.0%</b>	<b>419</b>	<b>100.0%</b>

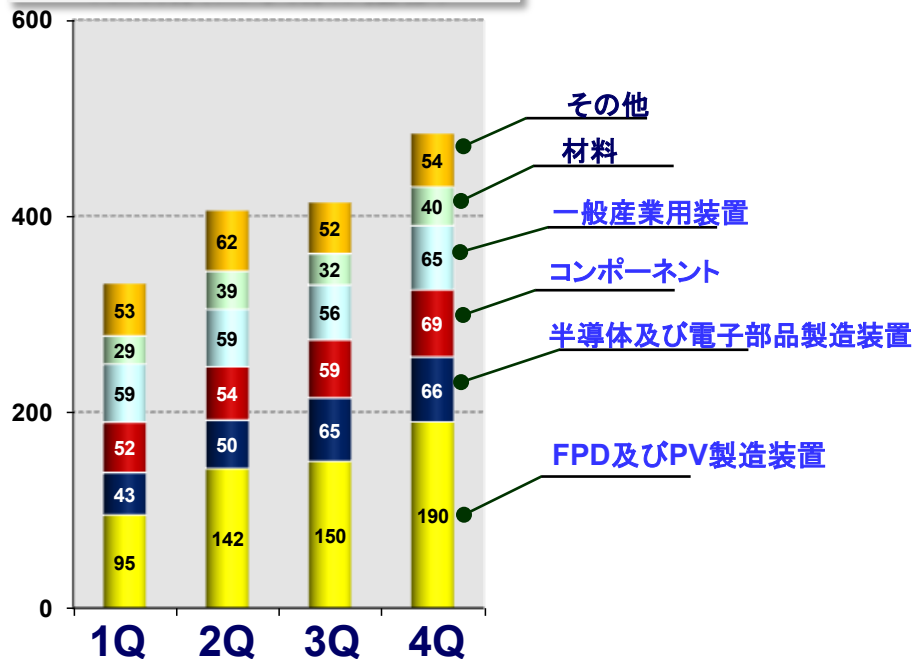
【記載された金額は四捨五入しておりますので各項目の合計値が一致しない場合があります。】

# 品目別売上高の実績

【単位:億円】



## 13/6期(四半期の推移)



【単位:億円】

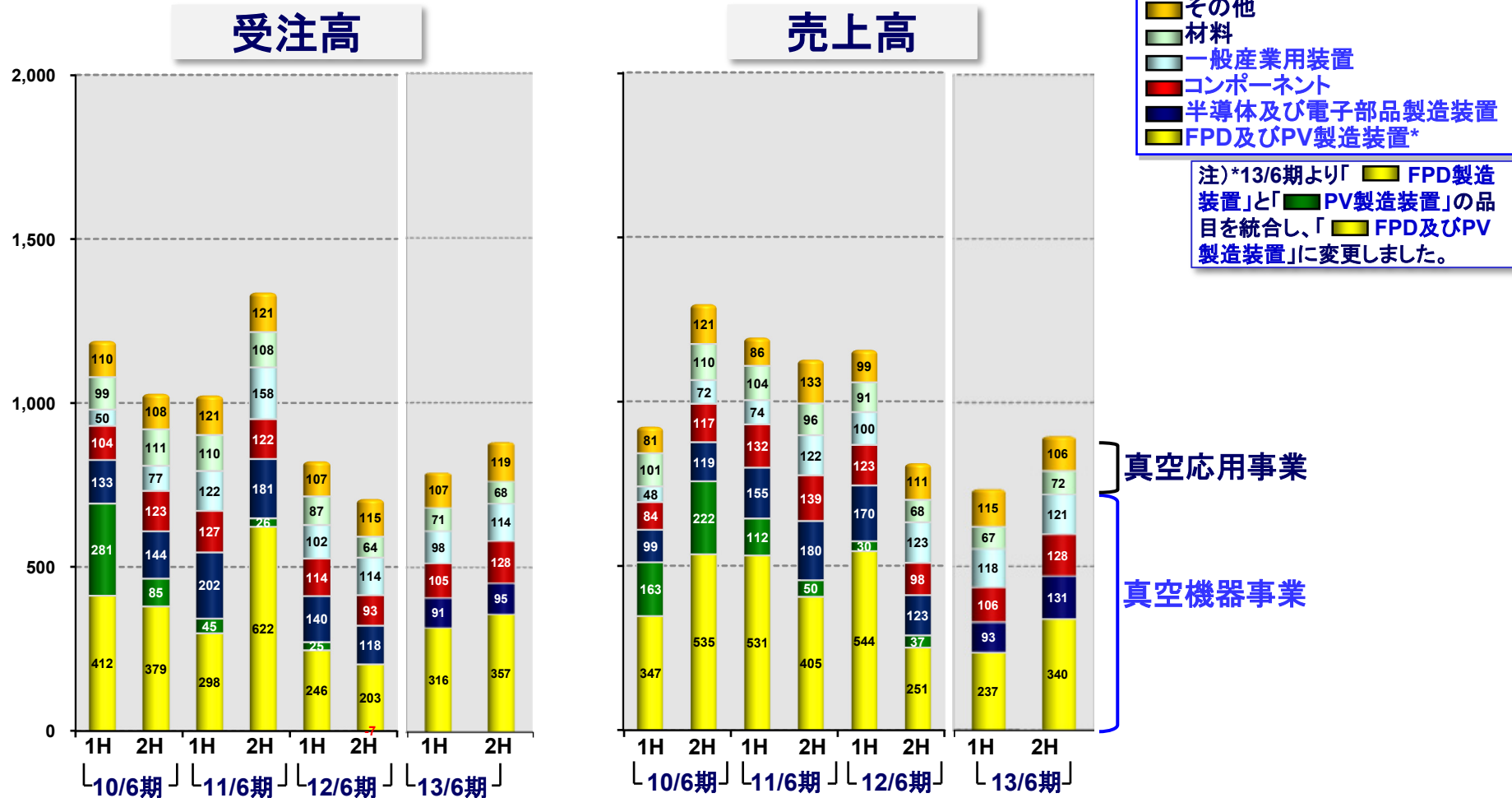
12/6期			13/6期			前年同期比 (増減率)	1Q		2Q		3Q		4Q	
セグメント	売上高	構成比	セグメント	売上高	構成比		売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比
真空機器事業	1,599	81.2%	真空機器事業	1,273	77.9%	-20.4%	249	75.2%	305	75.2%	329	79.6%	390	80.6%
FPD製造装置	795	40.4%	FPD及びPV製造装置	577	35.3%	-33.1%	95	28.7%	142	35.1%	150	36.2%	190	39.2%
PV製造装置	67	3.4%	半導体及び電子部品製造装置	224	13.7%	-23.5%	43	13.1%	50	12.2%	65	15.6%	66	13.7%
半導体及び電子部品製造装置	292	14.9%	コンポーネント	234	14.3%	5.5%	52	15.6%	54	13.4%	59	14.3%	69	14.2%
コンポーネント	222	11.3%	一般産業用装置	239	14.6%	7.2%	59	17.9%	59	14.4%	56	13.5%	65	13.5%
一般産業用装置	223	11.3%	真空応用事業	361	22.1%	-2.3%	82	24.8%	101	24.8%	84	20.4%	94	19.4%
真空応用事業	369	18.8%	材料	139	8.5%	-12.4%	29	8.6%	39	9.6%	32	7.7%	40	8.2%
材料	159	8.1%	その他	222	13.6%	5.4%	53	16.1%	62	15.3%	52	12.6%	54	11.2%
その他	210	10.7%	合計	1,634	100.0%	-17.0%	331	100.0%	405	100.0%	414	100.0%	484	100.0%
合計	1,968	100.0%												

【記載された金額は四捨五入しておりますので各項目の合計値が一致しない場合があります。】



# 品目別受注高/売上高推移(半期)

【単位:億円】



【記載された金額は四捨五入しておりますので各項目の合計値が一致しない場合があります。】

真空テクノロジーで /  
「つくる」をつくる、アルバック

ULVAC